

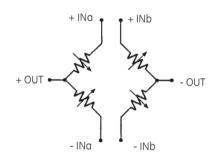
# P1302低压硅压力传感器芯片

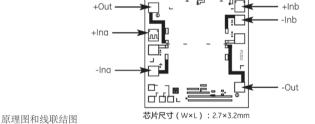
# 描述 NovaSensor®的P1302压阻压力芯片的尺寸为2.7x3.2mm。在恒定电流1.5mA激励下,P1302产生的毫伏电压输出和输入压力成线性比例。P1302适合做差压或表压的传感器。NovaSensor®的SenStable®工艺过程为P1302良好的长期稳定性和卓越的重复性提供了保障。

#### 特点

• 标准压力范围: 10in H<sub>2</sub>O(2.5kPa), 1psi(7kPa)

非线性度<0.25% FSO</li>最大过载压力: 5倍





## 特征参数

参数		数值	单位	备注
最大过载压力		5倍		额定压力
电气性能 (在25℃ (7	2°F) 下) 除非另有说明	月		
激励		1.5	mA	10VDC最大
输入阻抗		5000±20%	Ω	
输出阻抗		5000±20%	Ω	
工作温度		-40~125	°C	-40°F ~ 257°F
存储温度		-55~150	°C	-67°F ~ 302°F
介质兼容性		清洁、干燥空气和无腐蚀	虫性气体	
压力量程		2.5kPa	7kPa	
	单位	值 (备注1)	值 (备注1)	备注
零点偏移	mV	±75	±75	1
满量程输出	mV	40~120	75~200	
线性度	%FSO	±0.5	±0.25	2
压力迟滞	%FSO	±0.2	±0.2	
零点温度系数	μV/V/°C	±30	±30	
电阻温度系数	%/°C	0.29	0.29	3
灵敏度温度系数	%FSO/°C	-0.2	-0.2	3
零点热迟滞	%FSO	0.75	0.5	3
位置灵敏度	%FSO/g	0.1	0.1	4

备注: 1. 所有的测量值是在25°C (77°F) 和1.5mA输入激励下测得,除非另有说明。2. 非线性计算采用最佳拟合直线。3. 0~70°C之间,温度系数为典型值。4. 芯片顶部涂覆有硅胶的典型灵敏度数据。5. 芯片性能会因为芯片连接的材料变化,选择与芯片连接的材料时,应尽量减少封装应力对芯片的影响。

运输: 所有wafer发货时都放置在保护盒内, 晶圆和环贴放在胶带上。

所有的wafer都要进行电性能测试和外观检查。每个wafer都抽样检查其零点漂移,满量程输出和线性指标,电性能不合格品用红点标识。外观检查不合格品用蓝点标识。每片wafer都标有以下信息:批号,wafer编号,产品号,合格品数量。

### 订购信息

部件号: 描述: 部件号: 描述:

51317 2.5kPa D/G或0.36PSID/G(no glass/0.4mm, FSO:40-120mV) 51444 6.9kPa D/G或1PSID/G (93mil glass/2.8mm) 51318 7kPa D/G或1.02PSID/G(no glass/0.4mm) 51445 2.5kPa D/G或0.36PSID/G (93mil glass/2.3mm)

51433 2.5kPa D/G或0.36PSID/G (no glass/0.4mm, FSO:80-120mV)

最低订购量: 2wafers或900片左右







© 2018 安费诺公司版权所有。我公司保留未经通知更改技术规格的权利。 本文件中提及的其他公司名称或产品名称可能是其他公司的商标。 AAS-920-263B CN 06/2018

